

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: [0737820200](#)
Status: **Active**
Overview: [HDM® Backplane Connector System](#)
Description: HDM® Board-to-Board Stacking Header, High Rise Vertical, SMC, Closed End Option, 72 Circuits

Documents:

3D Model	Product Specification PS-73780-999 (PDF)
Drawing (PDF)	RoHS Certificate of Compliance (PDF)

Agency Certification

CSA	LR19980
UL	E29179

General

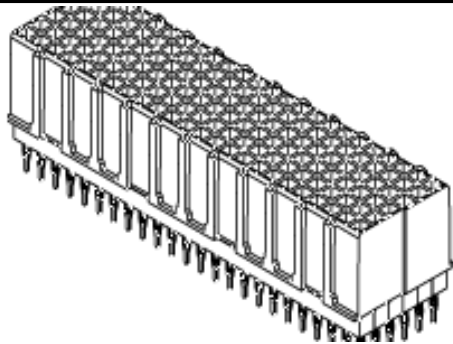
Product Family	Backplane Connectors
Series	73782
Application	Backplane, Mezzanine
Component Type	PCB Header
Overview	HDM® Backplane Connector System
Product Name	HDM®
UPC	800754874175

Physical

Circuits (Loaded)	72
Circuits (maximum)	72
Color - Resin	Black
Durability (mating cycles max)	200
First Mate / Last Break	No
Flammability	94V-0
Guide to Mating Part	No
Keying to Mating Part	None
Material - Metal	Phosphor Bronze
Material - Plating Mating	Gold
Material - Plating Termination	Tin-Lead
Material - Resin	High Temperature Thermoplastic
Net Weight	12.108/g
Number of Columns	12
Number of Pairs	Open Pin Field
Number of Rows	6
Orientation	Vertical
PC Tail Length	2.00mm
PCB Locator	No
PCB Retention	None
PCB Thickness - Recommended	1.40mm
Packaging Type	Tube
Pitch - Mating Interface	2.00mm
Plating min - Mating	0.762µm
Plating min - Termination	2.540µm
Polarized to PCB	No
Stackable	Yes
Surface Mount Compatible (SMC)	Yes
Temperature Range - Operating	-55°C to +105°C
Termination Interface: Style	Through Hole

Electrical

Current - Maximum per Contact	1.0A
-------------------------------	------



Series image - Reference only

EU ELV

Not Relevant

EU RoHS

Compliant

REACH SVHC

Contains SVHC(2014 December 17): No

Halogen-Free

Status

Low-Halogen

Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

China ROHS

ELV

Green Image

Not Relevant

Search Parts in this Series

[73782](#) Series

Mates With

[73632](#) HDM PLUS® Board-to-Board Daughtercard Receptacle. [73780](#) HDM® Board-to-Board Daughtercard Receptacle

Data Rate	1.0 Gbps
Real Signals (per 25mm)	72
Voltage - Maximum	100V AC

Solder Process Data

Duration at Max. Process Temperature (seconds)	005
Lead-freeProcess Capability	WAVE
Max. Cycles at Max. Process Temperature	001
Process Temperature max. C	260

Material Info

Reference - Drawing Numbers

Product Specification	PS-73780-999
Sales Drawing	SD-73782-001

HDM and High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation

This document was generated on 07/02/2015

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9